(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月25日(25.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/197207 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 7/29 (2018.01) *H01L 21/56* (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01) *H01L 23/29* (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)
C09J 201/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2024/043269

(22) 国際出願日： 2024年12月6日(06.12.2024)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-043485 2024年3月19日(19.03.2024) JP

(71) 出願人: 三井化学ＩＣＴマテリア株式会社(**MITSUI CHEMICALS ICT MATERIA, INC.**) [JP/JP]; 〒1040028 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 (JP).

(72) 発明者: 甲斐 喬士(**KAI Takashi**); 〒1040028 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 三井化学ＩＣＴマテリア株式会社内 (JP). 三浦 徹(**MIURA Toru**); 〒1040028 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 三井化学ＩＣＴマテリア株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 速水 進治，外 (**HAYAMI Shinji** et al.); 〒1410031 東京都品川区西五反田７丁目９番２号ＫＤＸ五反田ビル９階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

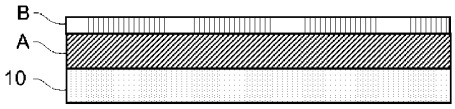
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：
— 国際調査報告（条約第21条(3)）

WO 2025/197207 A1

(54) **Title:** ADHESIVE FILM AND MANUFACTURING METHOD FOR ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称： 粘着性フィルムおよび電子装置の製造方法



50

(57) **Abstract:** An adhesive film (50) comprising an adhesive resin layer (B), an intermediate layer (A), and a base material layer (10) in this order, wherein the storage elastic modulus G' of the intermediate layer (A) is 4.0-50.0 kPa.

(57) 要約：粘着性樹脂層（Ｂ）と、中間層（Ａ）と、基材層（１０）と、をこの順番に備え、前記中間層（Ａ）の貯蔵弾性率G'が４．０ｋＰａ以上５０．０ｋＰａ以下である、粘着性フィルム（５０）。